



Memoria RAM DDR4 / 16 GB / 3200 MHz / CL19 / Intel XMP 2.0 / Disipador Armor Blanco / Perfil Bajo 31.25 mm

SKU: HS-C416-U32E2/I6G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias RAM

\$2,787.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de memoria DDR4 de 16 GB operando a 3200 MHz con latencia CL19, diseñado para estaciones de trabajo de edición de vídeo y configuraciones de gaming de alto rendimiento. Incorpora disipador Armor de aluminio en acabado blanco que garantiza estabilidad térmica continua bajo cargas sostenidas, eliminando el throttling por temperatura. Compatible con perfiles Intel XMP 2.0 para overlocking automático desde BIOS sin intervención manual. Su perfil bajo de 31.25 mm permite instalación sin interferencia bajo disipadores de CPU de torre de gran tamaño. Ofrece un ancho de banda de 25.6 GB/s, suficiente para timelines 4K multicapa, transmisión en paralelo y multitarea intensiva con aplicaciones de productividad y comunicación simultáneas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 16 GB DDR4<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia: 3200 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Latencia CAS: CL19<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: UDIMM de 288 pines<li style='margin-bottom: 8px;'>Perfil XMP: Intel XMP 2.0<li style='margin-bottom: 8px;'>Disipador: Armor de aluminio, color blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura del módulo: 31.25 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de banda: 25.6 GB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura máxima de operación: 85 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Plataformas Intel y AMD recientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: DDR4<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 16 GB<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 3200 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Latencia CAS: CL19<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de banda: 25.6 GB/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Perfil XMP: Intel XMP 2.0<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura máxima: 85 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: UDIMM 288 pines<li style='margin-bottom: 6px;'>Altura del módulo: 31.25 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Disipador: Armor de aluminio blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Intel y AMD recientes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo de memoria DDR4 16 GB 3200 MHz</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Overclocking automático con un clic mediante Intel XMP 2.0
Característica 2	Disipador Armor de aluminio blanco para estabilidad térmica sostenida
Característica 3	Latencia CL19 para respuesta inmediata en cargas de trabajo intensivas
Característica 4	Perfil bajo 31.25 mm compatible con coolers de torre de gran tamaño
Característica 5	Ancho de banda de 25.6 GB/s para edición 4K multicapa y gaming simultáneo
Característica 6	Compatibilidad dual Intel y AMD en plataformas de reciente generación